AUROMEX®

TECHNICAL

INSTRUCTIONS

DATA SHEETS

FOTRONEX G24

高速酸性純金鍍液

簡介:

AUROMEX FOTRONEX G24 爲一新改良的高速酸性純金配方,使用有機合成光澤劑(鍍層不含鎳或鈷成份),用以增加鍍金層之光亮度及硬度,耐磨度及防腐蝕性能,特別適用於電子或裝飾性等作薄鍍金的應用。操作簡易,合符經濟。

配方特性:

- * 陰極電鍍效率極高。
- *覆蓋能力特強,鍍層厚度分佈平均。
- * 防蝕性特強。
- * 鍍層內應力低。
- * 耐磨性特強。
- *操作簡易。
- *雜質容忍度高。

鍍層特性:

外觀: 鍍層光亮, 24K足金色。

純度:約99.9%以上

K 値 : 24 Kt.

硬度: 80-120 mHv20g.

密度: 18.0-18.5毫克/平方分米

色澤: 24K 足 金 色

P-1

電鍍設備:

鍍 槽: P.P 或 PVC。

發 熱 管:石英或不銹鋼熱筆。
 陽 極:白金鈦網或釘鈦網。
 攪 拌:強烈陰極機械攪拌。

鍍液配製程序:

所需物料: 氰化金鉀(含金量 68.3%) 14.7克

FOTRONEX G24 開缸鹽(Code 20000)1.5 公斤FOTRONEX G24 開缸光澤劑(Code 20001)100 毫升

FOTRONEX 調 酸 液 (Code 2090)

氫氧化鉀(KOH)

開缸程序:

1) 將 1.5 公 斤 開 缸 鹽 (Code 20000) 溶 於 6 公 升 純 水 或 蒸 溜 水 中 , 攪 拌 至 完 全 溶 解 。

- 2) 加入 100 毫升 開缸光澤劑 (Code 20001)。
- 3) 檢查及調整 pH 值至4.2, 可用10% 氫氧化鉀或 FOTRONEX 調酸液。
- 4) 加入14.7克氰化金鉀(含金量68.3%), 先溶於少量熱純水或蒸溜水中才加入溶液裏。
- 5) 攪拌及再次檢查pH値。
- 6) 加純水或蒸溜水至10公升。
- 7) 鍍液可隨時使用。

操作條件:

	<u>單 位</u>	<u>適中</u>	範 圍
含金量	克 / 公 升	1.0	0.5-1.5
pH 値		4.2	3.5-4.5
溫 度	$^{\circ}\! { m C}$	40	30-50
陰極電流密度(掛鍍)	安培 / 平方分米	1.0	0.5-2.0
(滾 鍍)		0.2	0.2-0.4
密 度	°Be(波美)	12.0	10-18
陽 極	白 金 鈦 網 (PT/T1)		
攪 拌		適 中	適 中
鍍 1 微 米 所 需 時 間	分	6.0	5-7
(正常電流 1A/dm²)			
陰極電流效率	毫克/安培分鐘	30	28-32

補充及控制:

- 1) 用氰化金鉀(含金量68.3%) 保持鍍液含金量在0.5-1.5克/公升,需預先溶於少量熱純水中才加進鍍液。
- 2) 每消耗及補充100克純金,即147克氰化金鉀(含金量68.3%), 需同時補充一單位(100毫升) FOTRONEX G24 "R"補充劑,正常補充可 參照以下計
 - 算法:每消耗3330安培分鐘,需補充100克純金及100毫升 (一單位) FOTRONEX G24 "R"補充劑。
- 3) 保持鍍液比重在10-18波美度之間,如比重過低可加入**FOTRONEX G24** 導電鹽,每加16克/公升導電鹽約可調高鍍液比重一波美度。
- 4) 保持 pH 値在 3.5-4.5 之間,如 pH 値過低,可用 10% 濃度的氫氧化鉀調正,如 pH 値過高,可加入 **FOTRONEX** 調酸液。
- 5) 鍍 液 如 受 其 他 金 屬 雜 質 (如 鎳 、 銅 等) 污 染 , 可 加 入 1-2 毫 升 **FOTRONEX CPX** 除 雜 水 , 以 保 持 鍍 層 純 度 。

包裝說明:

FOTRONEX G24 開缸劑	(Code 20000)	1.5 公斤/單位
FOTRONEX G24 開紅光澤劑	(Code 20001)	100 毫 升 / 單 位
FOTRONEX G24 補充劑 'R'	(Code 20005)	100 毫 升 / 單 位
FOTRONEX G24 導電鹽	(Code 20100)	1、2 或 5 公 斤 / 單 位
FOTRONEX G24 特別導電鹽	(Code 20150)	1、2 或 5 公 斤 / 單 位
FOTRONEX G24 調酸液	(Code 2090)	1、2 或 5 公 升 / 單 位
FOTRONEX G24 有機光劑	(Code 20015)	1、2 或 5 公 升 / 單 位
FOTRONEX CPX 除雜水		1、2 或 5 公 升 / 單 位